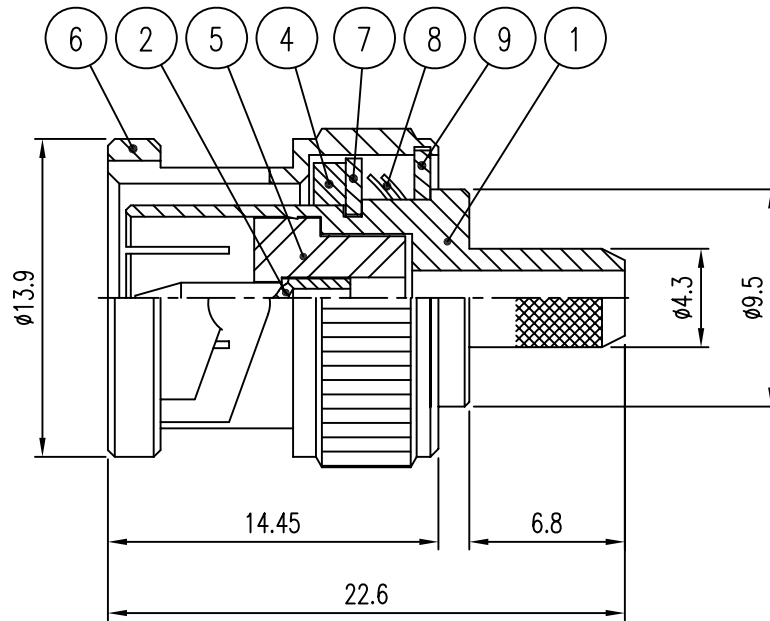


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	[첨변No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 배다 뒤편배를 추가	은선영	김인철	2018. 6. 20.
ST(개선)														



9	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
8	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
7	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00603-N/1 (H6480)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1 (G6001)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00054-1345/1 (F5011)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00553-135/1 (E6001)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00578-135/1 (D6113)

△1		1	BODY		1	MBSBD	Nickel Plate	DBD00578-135/1 (D6113)					
대체가능재질		품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고					
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05		년월일 2000. 4. 8.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.							
		승인											
재질		검도								도명 BNC-P-C-L910			
		제도											
열처리		작성부서 연 구 소				A4도번 CN00306-7/1 K327-004-000							
보호피막처리		적도 3/1		단위 mm	총량								